

## INVESTOR RELATIONS

2023년 2분기

Your Most trustworthy



## 유의사항 [Disclaimer]

본 자료는 한국채택국제회계기준 연결실적에 대한 경영실적 및 재무성과를 바탕으로 작성되었습니다.

또한 본 자료는 미래에 대한 "예측정보"를 포함하고 있으며, 이러한 "예측정보"는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 불확실성으로 인하여, 실제 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있습니다.

- 국내외 국가정책변경에 따른 세율 변동 (FTA, 관세, 법인세 등)
- 환율 및 이자 변동을 포함한 국내외 금융시장의 동향
- 주요 매출시장의 환경의 예상치 못한 급격한 변화
- 회사내의 전략적인 의사결정

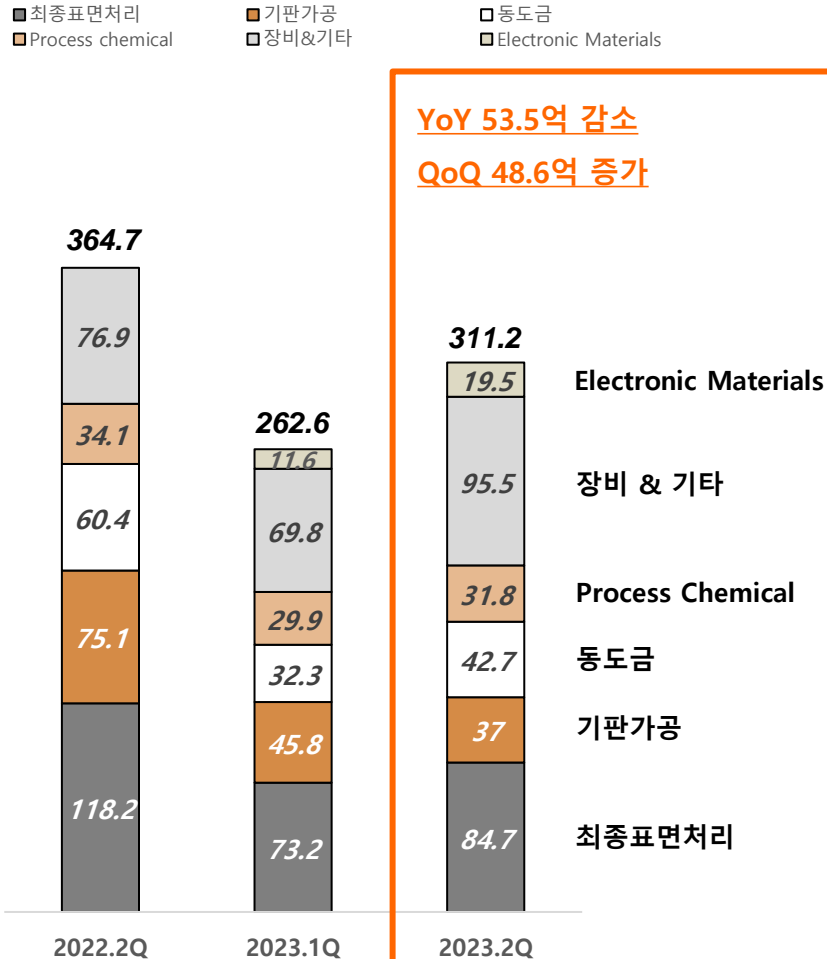
이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 "예측정보"에 기재되거나 암시된 내용과는 중대한 차이가 있을 수 있습니다.



## **2023.2Q REVIEW**

---

## Sales Report



### 실적Review

#### • 전 분기 대비 매출 상승

- ✓ 주요 고객사 비수기 및 FPCB 불황으로 인해 전년 동기 대비 53.5억원 (14.6%) 감소하였으나, 북미고객사 신규모델 양산시작으로 2분기 말 반등
- ✓ 북미 고객사向 PKG 기판의 물량 증가로 3분기 이후 매출 반등 예정이며, FC-BGA 시장 연평균 약 11% 성장이 전망되어 향후 PKG 고객사 向 매출 대폭 확대 예상

### Performance

- 23년 반기 PKG 고객사向 매출 : 103.8억원
  - PKG向 Chemical QoQ +0.2억(+0.4%)
  - PKG向 전자소재 QoQ +2.7억(+29.8%)

- ✓ PKG向 동도금, Process Chemical 제품의 실적 증가세 유지
- ✓ 하반기 메모리, FC-BGA 시장 확대로 지속적인 매출 성장예상

#### • 전자재료(소재) 사업부 매출 증대

- ✓ 2Q 매출 19.5억원 기록 하였으며 현 고객사 외 다수 PKG 기판 업체와 공정성 평가 진행 중 으로 4Q 이후 매출 확대 예상

- 태국 시장진출을 발판으로 해외 고객사 영업 확대 및 북미 반도체소 SEMICON WEST를 통한 세계 유수 대기업 엔지니어들과 Connection 기회 마련

## Income Statement

(단위:억원)

	2023.2Q	매출비중	2022.2Q	매출비중
I. 매출액	573.8	100%	671.8	100%
II. 매출원가	494.0	86.1%	497.9	74.1%
III. 매출총이익	79.8	13.9%	173.9	25.9%
판매비와 관리비	115.2	20.1%	140.7	20.9%
IV. 영업이익	-35.4	-6.2%	33.2	4.9%
금융수익	50.2	8.7%	55.8	8.3%
금융비용	25.5	4.4%	32.2	4.8%
기타수익	6.4	1.1%	6.0	0.9%
기타비용	0.7	0.1%	4.5	0.7%
지분법손익	0.0	0.0%	0.0	0.0%
V. 법인세차감전순이익	-5.0	-0.9%	58.3	8.7%
법인세비용	-22.7	-3.9%	17.5	2.6%
VI. 당기순이익	17.7	3.1%	40.8	6.1%

### 주요 수익성 지표

	2023.2Q	2022.2Q
영업이익률	-6.2%	4.9%
순이익률	3.1%	6.1%
EBITDA	6.3	70.4
EBITDA (마진율)	1.11%	10.48%
ROE	0.7%	2.2%
총자산회전률	22.5%	27.0%

- ✓ 인건비 상승 및 투자설비 증설에 따른 감가상각비 상승으로 고정비 및 원가율 증가.
- ✓ 신사업 관련 투자지출 지속에 따른 수익성 악화.
- ✓ 23년 3Q 부터 원가 및 비용절감 정책 진행으로 하반기 수익성 개선 추진.

## Balance Sheet

(단위:억원)

	2023.2Q	2022
자산		
현금성자산	558.6	531.4
매출채권	222.8	222.1
재고자산	157.7	189.2
유형자산	1,193.5	1,103.5
기타자산	487.6	432.9
<b>자산총계</b>	<b>2,620.2</b>	<b>2,479.1</b>
부채		
매입채무	441.0	33.8
차입금	237.3	503.7
신주인수권부사채	97.7	89.9
기타부채	303.1	338.1
<b>부채총계</b>	<b>1,079.1</b>	<b>965.5</b>
자본		
자본금	81.6	81.6
자본잉여금	357.0	360.1
기타자본	58.4	45.8
이익잉여금	774.8	763.2
비지배지분	269.3	262.9
<b>자본총계</b>	<b>1,541.1</b>	<b>1,513.6</b>
부채와 자본총계	2,620.2	2,479.1

## Cash Flow

(단위:억원)




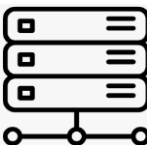
	2023.2Q	2022.2Q
기초현금	531.4	701.9
영업활동으로 인한 현금흐름	15.2	35.5
당기순이익	17.6	40.9
감가상각비	41.7	37.2
법인세비용	(22.7)	17.5
파생상품평가이익	(26.5)	(13.0)
기타	5.1	(47.1)
투자활동으로 인한 현금흐름	(160.2)	(245.3)
유무형자산의 처분(취득)	(121.7)	(185.3)
금융상품의 감소(증가)	(20.4)	(81.8)
기타	(18.1)	21.8
재무활동으로 인한 현금흐름	168.8	(10.2)
차입금의 증가(감소)	174.6	(5.4)
기타	(5.8)	(4.8)
현금증감	23.8	(220.0)
환율변동효과	3.4	16.5
기말현금	558.6	498.4

## 사업 전망

---

## PCB 시장 동향 (2022-2027)

- ▶ 전방산업동향에 따른 PCB 시장의 중장기적 변화는 **2023년 전세계 \$81.8Bn 에서 27년 \$98.4Bn로 20% 이상 성장** 할 것으로 예측
- ▶ 5년 간의 주요 Trends는 **AI, Server, Storage 및 Automotive 시장의 EV 전환 가속**에 따른 전자제품의 수요 급증 예측
- ▶ 전방시장별 성장예측과 그에 따른 산업별 변화 및 PCB 시장의 영향은 하기와 같습니다.

	23/22	2022~2027	Application	PCB
	-9%	2.6%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fanout AP 적용 확대</li> <li>• SLP 확대</li> <li>• RCC 적용 등 경박단소 고도화</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 전기 패턴도금 고사양 패턴 구현방식의 범용화 가속</li> <li>• Material 변화에 따른 신규 약품 개발 needs 증가</li> </ul>
	-18%	2.8%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 25년, DDR4→DDR5 전환</li> <li>• HBM, DDR5 고성능 DRAM 적용</li> <li>• Vision Pro식 고성능 SRAM시장 확대전망</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 고사양 DRAM의 신규 채용 증가에 따른 PCB 제품의 고도화 → SAP 채용, 패턴도금 미세화, Low Dk,Df 원소재 채용 증가</li> </ul>
	5%	9.3%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EV제품의 전자 제품화 → AP, Memory 수요</li> <li>• 고신뢰성 기반의 FC-BGA 채용 예상</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FC-BGA 고사양 대면적화</li> <li>• 다층 채용 증가에 따른 미세회로 패턴 구현 기술 요청</li> <li>• 2.5D / 3D PKG 증가에 따른 PCB Solution 필요</li> </ul>
	2%	6.4%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AI 중심의 성장세 지속 → Fanout, HBM</li> <li>• 5G, Data Server 성장세 지속 예상</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FC-BGA의 수요 증가 및 대면적화, 다층화, 가속화 예상</li> <li>• MLB Type의 Low Df제품의 증가</li> <li>• SIP제품의 Density 증가 가속화</li> </ul>

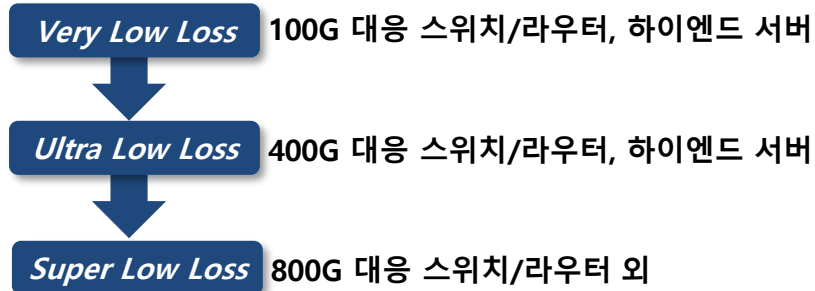
Your most trustworthy

Source : Prismark



## 전자 소재 시장 전망 (5G, 저유전소재 전망)

▶ 5G, Server, AI 관련 저유전 소재에 대한 시장의 니즈는 지속적으로 강화되고 있으며, 각 Application 관련 대응 가능 자재는 하기와 같음



▶ 23년부터 800G 라우터 시장의 개발 및 양산이 본격화 됨에 따라서 하기와 같은 Material 채용이 늘 것으로 전망함



YMT 주요 FPCB 고객사별 Application 동향

\*업체명은 임의로 기입

업체	A社	B社	C社	D社	E社
현재 Application	-스마트폰 디스플레이 -배터리 가전 -자동차용 디스플레이 -전기차 배터리 케이블	-스마트폰 디스플레이 -가전 디스플레이 -Wearable	-스마트폰 디스플레이 -태블릿 Touch Sensor -배터리 -전기차 배터리 케이블	-카메라 모듈 -무선충전 -VR, Wearable -스마트폰 지문인식	-스마트폰 디스플레이 -Touch Sensor -TAP 디지털타이저 - 카메라 모듈
향후 진입 Application	-테블릿 용 OLED -노트북 용 OLED	-전기차 배터리 케이블 -차량용 카메라 모듈	-	-전기차 배터리 케이블	-스마트폰 OLED Display
End-user	삼성전자, 애플 삼성SDI	삼성전자, 애플 구글	삼성전자, 샤오미 화웨이	삼성전자, 구글 LG 에너지솔루션	삼성전자, 애플

→ 당사의 주요 고객사는 한국, 중국, 대만의 FPCB 회사들이며, 기존의 End user는 스마트폰 제조사에 한정되어 있었으나 현재 전기차, 통신칩 등 고부가가치 산업으로 확대 중

YMT 주요 **PKG** 고객사별 Application 동향

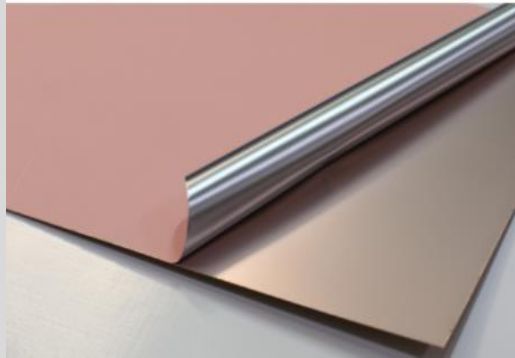
\*업체명은 임의로 기입

업체	F社	G社	H社	I社	J社	K社
현재 생산 품목	-FC-CSP -SiP -AiP -FC-BGA	-SiP -AiP -FC-CSP -FC-BGA	-FC-BGA -FC-CSP -SiP -FC-BOC	-FC-CSP -SiP	-FC-BGA -FC-BOC	-FBGA
향후 진입 시장	-HPC -2.5D, 3D PKG	-HPC -2.5D, 3D PKG	-전장 -RF반도체 -안테나	-전장 -RF반도체 -안테나	-RF반도체 -전장	-DDR5 -DDR6 -GDDR6 -GDDR7
End-user	인텔, 삼성전자	브로드컴, 애플 NXP	삼성전자, SK하이닉스 엠코 등	삼성전자, SK하이닉스 마이크론 등	삼성전자, SK하이닉스 브로드컴 등	삼성전자, SK하이닉스

→ 당사는 한국의 PKG Substrate 제조사로 확대 중이며 FC-BGA 시장의 확대에 따라 고부가가치 제품의 공급 확대를 통해 매출 및 수익성 증대 예상

## YMT 소재솔루션사업부문 진행상황

### 나노투스동박 영업 상황



- ▶ '22년 10월 첫 양산 공급 후, 현재 고객사의 제조 모델 횡전개로 물동량 증가 '23.2Q 월 생산량 12,000m<sup>2</sup>, 분기 매출 12억 보이고 있음.  
Automobile 센서용 모델 신규 채용 시 '23.4Q 이후 생산량 증가가 예상.
- ▶ 고객사, 20 pitch 수율 향상을 위해 채용 증가 예상
- ▶ 현재 공급하고 있는 고객사 외 국내외 다수 패키지 기판 업체와 미세회로 구현 목적의 공정성 평가를 진행 중.

▶ '24년 물량 증가 및 고객 다변화 대응 위한 선제적 나노투스 극동박 생산 인프라 (1.5세대)를 현 안산 공장에 '23년 12월까지 구축, 35,000m<sup>2</sup>/월 생산 Capa 확보 예정임.

▶ 자사 소재 기술의 글로벌 홍보 및 Supply Chain 내 고객사에 대한 기술 소개를 위해 7월 북미 반도체쇼 (SEMICON-WEST) 부스 참가를 진행하였으며, 나노투스 극동박을 중심으로 한 반도체 패키지 미세회로 및 고속통신 기술 대응 Chemical 소재에 대해 NVIDIA, AMD, APPLE, IBIDEN 등을 포함한 세계 우수 기업 엔지니어들과 소통하였음.



## YMT 소재솔루션사업부문 진행상황

### 전자 소재 진행 상황

#### ▶ 고속 통신 및 네트워크/통신용 소재

- 1) Low Df-5G 대응 소재 : 당사의 Low Df-5G 대응 저유전 소재에 대한 고객사 평가 완료 후, 최종 Set 신뢰성 평가 진행 중으로 '23년 11월 양산 적용 예상.
- 2) 네트워크/통신용 전자파차폐 소재 : Global 5G 네트워크 시장 부진이 있으나, 서버 SSD 및 중화계 통신용 소재로서 당사 소재 신규 승인완료, '23.4Q 이후 매출 회복 기대.

#### ▶ Smartphone Camera 모듈용 절연필름

- Global Mobile 시장 침체로 확대 지연되고 있으나, 신규 고객 승인 전개 (M사(日) 승인 완료, S사(韓) 평가중) 통한 '23.4Q 이후 매출 회복 기대됨.

#### ▶ OLED Metal Encap.

- 고객사와의 현 적용 소재 (Invar, 일본업체 독점 공급) 대체 소재로서의 FS (Feasibility) 평가 8월 완료하여, 후보 요소 소재 기술로 놓고 고객사의 OLED TV 전략 방향에 따라 추후 양산 진행 여부 결정이 이루어 질것으로 예상.

**Phase I: 자원 재배치 및 신규시장 침투 ('22 ~ '23)**

**Phase II: 시장점유율 확대 ('24 ~ '25)**

**Phase III: 종합 부품소재 회사 ('26 ~)**

Chemical Division

Business

- 반도체 PKG용 화학소재 매출 증대
  - F/RF-PCB → PKG 비중 확대
- 5G 관련 화학소재 개발
  - Ni-Less 표면처리약품 (Optimus), Nanotus 기술 적용
- FPCB 생산기지 이전에 따른 인적, 물적 자원의 재배치

Capex

- 반도체 PKG용 화학소재 매출 비중 확대
  - F/RF-PCB 매출 < PKG 매출
- 5G용 화학소재 본격화
  - 고객사 승인 완료 후 본격 양산
- 중국 시장 매출 본격화
- 자동차, 항공 등 고부가 시장 진출
- 중국 주해 공장 가동
- 베트남 공장 약품 생산 시작

- Wafer 동도금 화학소재 진출
  - 반도체 관련 시장 확대
- 6G용 화학소재 개발
  - 고객사 협력을 통한 선행 개발 후 본격 사업화
- PKG 약품 공급을 위한 국내 약품제조 시설 업그레이드
- 주해 공장 가동률 향상 (약품, 외주)

*신규 Business*

Materials Division

Business

- 고객사 양산 스타트 및 고객사 수 확대
  - PKG 제조사 및 End User 영업강화
- 양산 효율화
  - 외주공정 내재화
  - 비용 효율화
- 디스플레이 분야 신규 아이템 사업화

Capex

- 극동박 본격적 매출 확대
  - 기술우위를 통한 5G 시장 공략
  - 외형확대를 통한 이익률 상승
- 동박의 연계 Application 시장 침투
  - 저유전 소재, 차폐 소재 등
- 디스플레이 신규 아이템 양산
- 동박 신규공장 안정화 및 가동률 상승
  - 국내 신규공장 가동 시작 및 매출확대
- Application 생산을 위한 추가 공장 건설

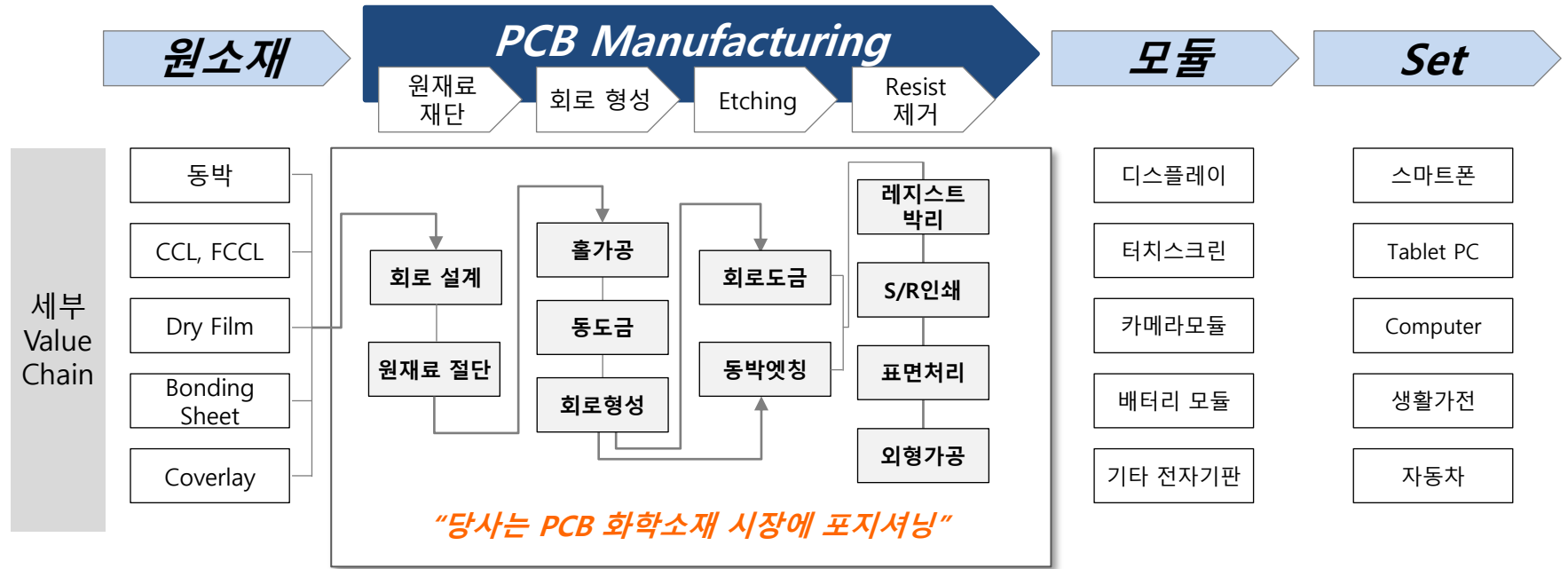
- 극동박 해외 시장 매출 확대
  - Global Set, Chip 회사들과의 협업
- 동박을 활용한 다양한 모듈 및 부품의 생산 안정화 및 매출 확대
- 모듈 제작을 위한 공장 증설
- 해외공장 가동 및 안정화

# 사업부 소개

---

- PCB 사업부

PCB Industry value chain



당사의 주요 포지셔닝은 PCB 화학소재이며 특히 부가가치가 높은 최종표면처리 및 화학동도금 Segment에서 주요 매출이 발생되고 있습니다.



주요고객사 (Major Customer)

“주로 한국, 중국, 대만의 FPCB 회사들이 주요 고객사이며, 최근 한국의 PKG Substrate 제조사로 고객사 확대 중”  
 End User 또한 기존 스마트폰 제조사에 한정되어 있었으나 전기차, 통신칩 등 첨단 산업으로 확대

FPCB Customer	   
	   
	   
PKG Substrate	    

## Total Solution for Customer

와이엠티는 공정의 첫 단계인 세정/박리제부터 최종표면처리까지, 모든 화학소재 기술을 보유함으로써 고객사 설비 특성에 맞는 **Total chemical solution**을 제공하고 있습니다.



### Final Finishing Chemical

#### **Soft ENIG Process**

- ✓ CF 300 Series
- ✓ MIKO Series

#### **ENIG Process**

- ✓ PEN Series
- ✓ MIKO Series

#### **ENEPIG Process**

- ✓ PEN Series
- ✓ ELP or ZEP Series
- ✓ IR Gold Series

#### **EPIG process**

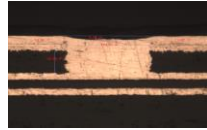
- ✓ ZEP Series
- ✓ IR Gold Series

#### **Immersion process**

- ✓ PROTIN Series

#### **Electrolytic gold process**

- ✓ HG 300 series
- ✓ SAU 10 series



### Copper plating chemical

#### **Electroless Copper plating**

- ✓ HVF Series
- ✓ MJH series

#### **Electrolytic Copper plating**

- ✓ BJ series
- ✓ HBJ Series(Half-fill)
- ✓ FSBJ Series(flash plating)
- ✓ ZEUS Series(Via-fill)



### Process Chemical

#### **DES Chemical**

- ✓ MSAP/SAP DFR Stripper
- ✓ MSAP/SAP Cu seed Etchant
- ✓ GMZ Series
- ✓ HWA Series

#### **Cleaner**

- ✓ FXC Series
- ✓ EQ Series

#### **Gold Recover**

#### **UBM Etchant**

#### **LAZ Process**



### New product for 5G

#### **No etching and roughness laminating pretreatment**

#### **Ultra low profile detachable thin copper foil**

#### **Positive Cu roughening**

#### **Process Nanotus®**

#### **Electroless Copper plating for LCP**

# 사업부 소개

---

- 소재솔루션 사업부

Nanotus(나노투스) 극동박(Ultra thin copper foil)은 도금기술을 활용, 표면에 미세한 돌기를 형성하여 밀착력과 전송손실 모두를 만족하는 차세대 동박으로 End-User의 승인 완료 후 현재 전장용 5G통신용 기판으로 양산, 공급중에 있음

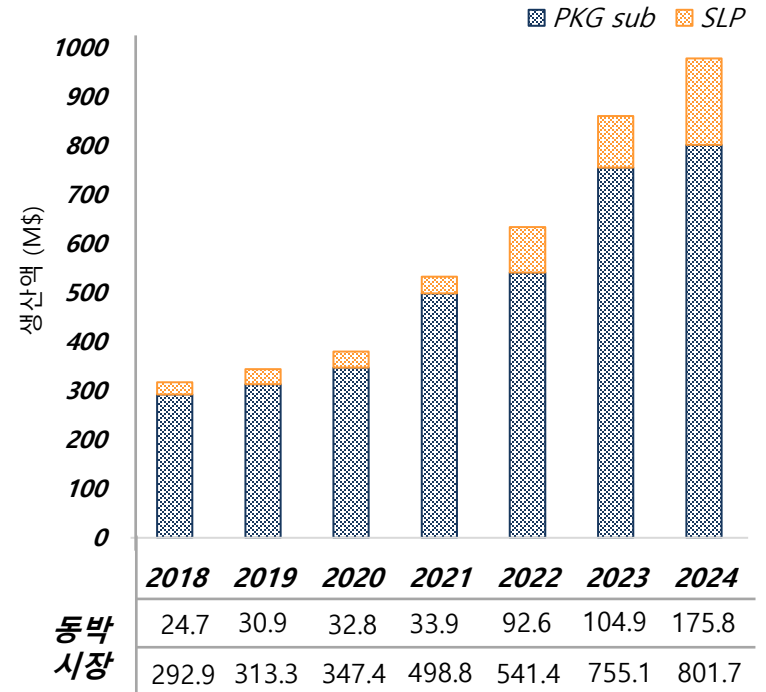
동박 시장의 분류

두께	용도	주요업체
1um~3um	<ul style="list-style-type: none"> <li>PKG 기판의 원소재로 Msap 및 SAP 공법에 적용</li> </ul>	일본 미쓰이社(독점)
6um~8um	<ul style="list-style-type: none"> <li>전기차 음극재</li> <li>PCB</li> </ul>	SK넥실리스(한국), 왓슨(중국), 창춘(대만), 일진머티리얼즈(한국)
10um~	<ul style="list-style-type: none"> <li>일반 PCB</li> </ul>	중국업체 중심 국내 일부 업체

Key factor

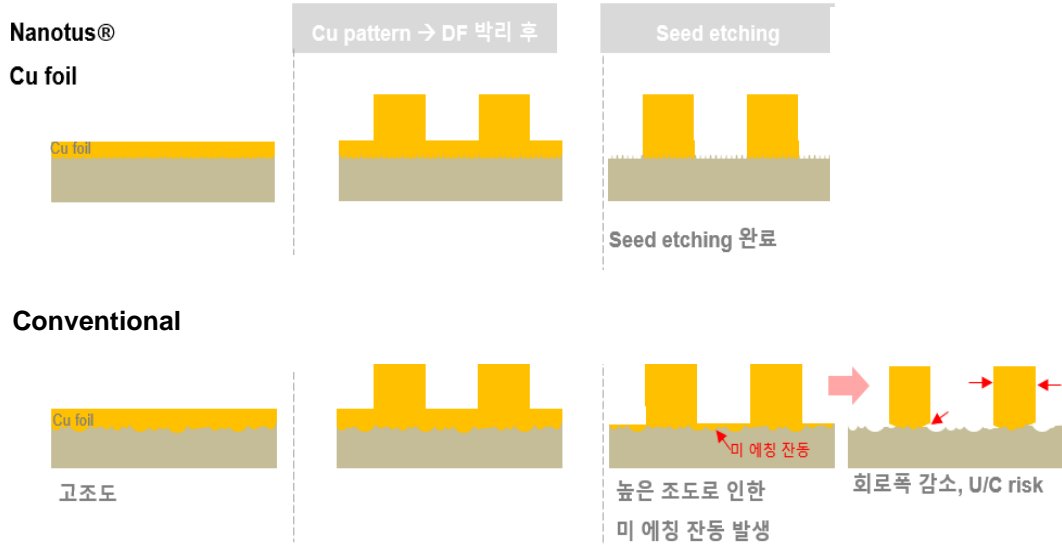
- 표면의 조도 (평탄도)
  - 조도가 클수록 밀착력은 상승하나 신호의 전송측면에서 불리
- 얇으면서도 균일한 두께의 동 표면
  - 회로형성과정에서 에칭하여 구리 표면이 사라지게 되는 균일하지 않은 표면을 에칭할 경우 과도한 약품 사용으로 회로가 손상
  - 이에 동박의 얇은 두께는 미세회로 구현의 필수 요소

PKG 기판 시장 자체의 성장과 제조방식인 Msap,SAP 공법 적용의 확대로 2024년 1조원대로 성장 전망

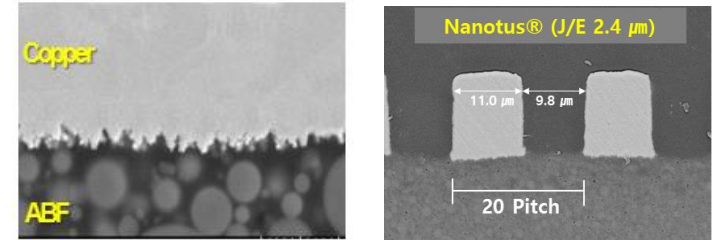


**Nanotus® 동박의 기술적 포인트**

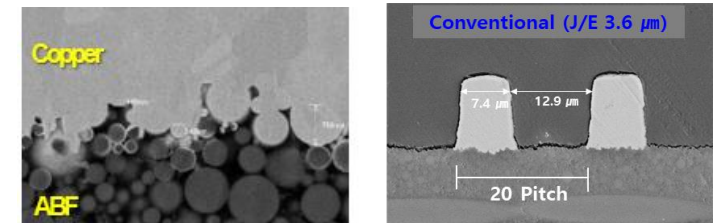
- 현 공법은 절연필름을 에칭한 표면을 이용하여 밀착력을 확보하기 때문에 Control이 어려워 표면이 일정치 않음 → 미세회로 구현 시 불리
  - 별도의 에칭장비 또한 필요하며, 현 동박과 절연필름 공급부족 전망
- 절연필름을 에칭하지 않기 때문에 일정한 조도의 표면을 구현, 미세회로 구현에 적합
  - 별도의 투자없이 공정 진행가능
  - 절연필름을 에칭하지 않기 때문에 절연필름의 손상이 없음. 이에 제품 구현시 이론상의 Spec을 그대로 발휘
  - 향후 현재 시장을 독점하고 있는 A社 외 제품의 사용이 가능할 것으로 전망



• 우수한 미세회로 구현 능력 Nanotus



• 기존 공법 : 비균일한 조도로 회로폭 손상



***End of Document***

---